

超配（维持）

半导体行业双周报（2024/05/13-2024/05/26）

中芯国际跃升全球第三大芯片代工巨头

2024年5月26日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

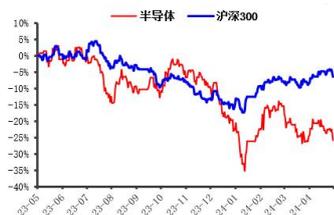
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2024年5月24日，申万半导体板块近两周（2024/5/13-2024/5/26）下跌5.53%，跑输沪深300指数3.77个百分点；5月以来累计下跌6.61%，跑输沪深300指数6.53个百分点；2024年以来累计下跌19.22%，跑输沪深300指数24.19个百分点。
- **半导体行业指数子板块近两周涨跌幅：**截至2024年5月24日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，涨跌幅从高到低依次为：SW集成电路封测（-0.34%）>SW半导体设备（-1.12%）>数字芯片设计（-2.66%）>SW模拟芯片设计（-3.54%）>SW半导体材料（-3.66%）>SW分立器件（-5.21%）。
- **近两周部分新闻和公司动态：**（1）通义千问GPT-4级主力模型降价97% 1块钱200万tokens；（2）三星、SK海力士对通用存储芯片增产持保守态度；（3）讯飞星火API顶配版低至0.21/万Tokens，价格为百度阿里五分之一；（4）消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇外型封装；（5）大模型价格战愈演愈烈，互联网巨头激战正酣；（6）消息称三星半导体代工部门已将“赢得英伟达3nm产品订单”作为今年首要任务；（7）集邦咨询：2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%；（8）Canalys：Q1紫光展锐处理器出货量同比增长64%，达到2600万颗；（9）英伟达发布强劲营收预测，凸显人工智能势头持续；（10）中芯国际首次超越格罗方德和联华电子，跃升全球第三大芯片代工巨头；（11）中微公司尹志尧：未来5-10年目标覆盖50%-60%的集成电路关键设备。
- **周报观点：景气上行与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。**2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖（以智能手机、PC为代表）、AI驱动行业创新（以AI服务器、PCB等为代表）和国产替代持续推进（以半导体设备、材料为代表）的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。
- **风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

目录

1. 半导体行业行情回顾	3
2. 半导体产业新闻	4
3. 公司公告与动态	6
4. 半导体产业数据更新	7
4.1 智能手机出货数据	7
4.2 新能源汽车销售数据	7
4.3 全球、国内半导体月度销售数据	7
4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据	8
5. 投资建议	8
6. 风险提示	11

插图目录

图 1: 半导体行业 2021 年初至今行情走势 (截至 2024 年 5 月 24 日)	3
图 2: 全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/03)	7
图 3: 国内智能手机月度出货情况 (2022/03-2024/03)	7
图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 (2022/01-2024/04)	7
图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 (2022/01-2024/04)	7
图 6: 全球半导体月度销售情况	8
图 7: 中国半导体月度销售情况	8
图 8: 全球半导体设备销售额 (季度)	8
图 9: 中国大陆半导体设备销售额 (季度)	8

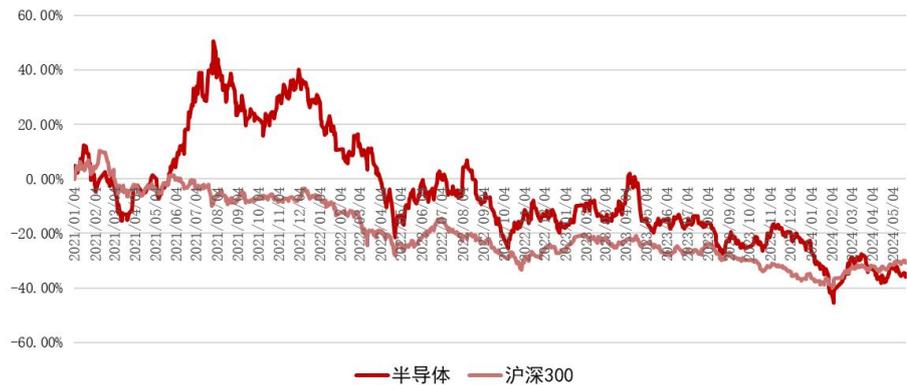
表格目录

表 1: 申万半导体行业各子板块涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 5 月 24 日)	3
表 2: 申万电子所有三级子行业涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 5 月 24 日)	3
表 3: 建议关注标的介绍 (2024/5/24)	9

1. 半导体行业行情回顾

半导体行业指数近两周涨跌幅：截至 2024 年 5 月 24 日，申万半导体板块近两周（2024/5/13-2024/5/26）下跌 5.53%，跑输沪深 300 指数 3.77 个百分点；5 月以来累计下跌 6.61%，跑输沪深 300 指数 6.53 个百分点；2024 年以来累计下跌 19.22%，跑输沪深 300 指数 24.19 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 5 月 24 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

截至 2024 年 5 月 24 日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，涨跌幅从高到低依次为：SW 集成电路封测（-0.34%）>SW 半导体设备（-1.12%）>数字芯片设计（-2.66%）>SW 模拟芯片设计（-3.54%）>SW 半导体材料（-3.66%）>SW 分立器件（-5.21%）。

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 5 月 24 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850812.SL	分立器件	-5.21	-6.48	-23.93
2	850813.SL	半导体材料	-3.66	-4.46	-19.86
3	850814.SL	数字芯片设计	-2.66	-3.64	-12.49
4	850815.SL	模拟芯片设计	-3.54	-4.62	-30.57
5	850817.SL	集成电路封测	-0.34	-0.43	-14.66
6	850818.SL	半导体设备	-1.12	-5.09	-7.47

资料来源：iFind、东莞证券研究所

表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 5 月 24 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850813.SL	半导体材料	-3.66	-4.46	-19.86
2	850818.SL	半导体设备	-1.12	-5.09	-7.47
3	850814.SL	数字芯片设计	-2.66	-3.64	-12.49
4	850815.SL	模拟芯片设计	-3.54	-4.62	-30.57
5	850817.SL	集成电路封测	-0.34	-0.43	-14.66

6	850812.SL	分立器件	-5.21	-6.48	-23.93
7	850853.SL	品牌消费电子	-2.41	-1.68	-12.10
8	850854.SL	消费电子零部件及组装	4.75	4.15	-6.01
9	850861.SL	电子化学品III	-3.07	-2.70	-17.53
10	850831.SL	面板	-1.84	-2.81	-6.27
11	850832.SL	LED	1.42	1.07	-17.09
12	850833.SL	光学元件	0.52	-2.24	-16.61
13	850822.SL	印制电路板	3.16	1.86	4.46
14	850823.SL	被动元件	-2.45	-1.97	-8.62
15	850841.SL	其他电子III	1.27	-0.25	-12.30

资料来源：iFind、东莞证券研究所

2. 半导体产业新闻

1. 【通义千问 GPT-4 级主力模型降价 97% 1 块钱 200 万 tokens】

《科创板日报》21 日讯，阿里云宣布通义千问 GPT-4 级主力模型 Qwen-Long，API 输入价格从 0.02 元/千 tokens 降至 0.0005 元/千 tokens，直降 97%。这意味着，1 块钱可以买 200 万 tokens，相当于 5 本《新华字典》的文字量。这款模型最高支持 1 千万 tokens 长文本输入，降价后约为 GPT-4 价格的 1/400。

2. 【三星、SK 海力士对通用存储芯片增产持保守态度】

《科创板日报》22 日讯，三星、SK 海力士在提高标准 DRAM 和 NAND 芯片产量方面仍保持保守态度。此前，8Gb DDR4 DRAM 通用内存的合约价在四月份环比上涨，这主要是因为地震影响美光内存产能，短时间内推动通用内存需求走高。整体来看通用存储芯片市场仍存在不确定性。此外，HBM 内存需求旺盛，在三星电子、SK 海力士积极扩产 HBM 的背景下，通用 DRAM 的晶圆投产量势必得到抑制。

3. 【讯飞星火 API 顶配版低至 0.21/万 Tokens 价格为百度阿里五分之一】

财联社 5 月 22 日电，科大讯飞 5 月 22 日宣布，讯飞星火 API 能力正式免费开放。其中，讯飞星火 Lite API 永久免费开放，讯飞星火顶配版（Spark3.5 Max）API 价格低至 0.21/万 Tokens。目前百度文心一言 ERNIE-4.0 和阿里通义千问 Qwen-Max 的定价为 1.2 元/万 Tokens，讯飞星火定价不足其五分之一。

4. 【消息称英伟达计划将 GB200 提早导入面板级扇外型封装】

《科创板日报》22 日讯，供应链透露，为缓解 CoWoS 先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其 GB200 提早导入面板级扇外型封装，从原订 2026 年提前到 2025 年。相关报告也证实相关消息，并点出英伟达 GB200 供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段；从 CoWoS 先进封装产能研判，今年下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场，明年产出量上看 150 万至 200 万颗。整体来看，在 CoWoS 产能供不应求

的趋势下，业界预期同样是先进封装的面板级扇外型封装，有望成为纾解 AI 芯片供应的利器。

5. 【大模型价格战愈演愈烈 互联网巨头激战正酣】

财联社 5 月 22 日电，在持续了一年多的国产大模型鏖战后，云计算大厂终于陷入以价格换市场的老套路中。5 月 21 日，阿里云宣布通义千问大模型降价，其中 GPT-4 级主力模型 Qwen-Long 降价幅度甚至达到 97%，API 输入价格从 0.02 元/千 tokens（文本中的基本单位）降至 0.0005 元/千 tokens。一元钱买不到一个包子，却可以买 200 万 tokens；另一大模型头部企业百度，宣布文心大模型的两大主力模型 ERNIE Speed 和 ERNIE Lite 全面免费，立即生效；就在上周，字节跳动在火山引擎原动力大会上发布豆包大模型，并喊出“0.8 厘就能处理 1500 多个汉字，比行业便宜 99.3%”的口号。这意味着，大模型 API 调用的“免费时代”或将正式开启。

6. 【消息称三星半导体代工部门已将“赢得英伟达 3nm 产品订单”作为今年首要任务】

《科创板日报》21 日讯，继 HBM 之后，三星电子今年的首要任务是在半导体代工方面获得英伟达的订单。据业内人士透露，三星电子半导体代工部门（DS）已在内部将“赢得英伟达 3nm 产品订单”作为今年的首要任务。“各部门正在全力以赴，通知集合英语流利的员工，与‘Nemo’接单相关的工作将优先于现有工作。”Nemo 是三星电子内部的客户代号，用于指代英伟达。（韩国 FNNNews）

7. 【集邦咨询：2024 年底 HBM 投片量预估占先进制程比重 35%】

财联社 5 月 20 日电，据集邦咨询研究，三大原厂开始提高先进制程的投片，继存储器合约价翻扬后，公司资金投入开始增加，产能提升将集中在今年下半年，预期 1α nm（含）以上投片至年底将占 DRAM 总投片比重约 40%。其中，HBM 由于获利表现佳，加上需求持续看增，故生产顺序最优先。但受限于良率仅约 50~60%，且晶圆面积相较 DRAM 产品，放大逾 60%，意即所占投片比重高。以各家 TSV 产能来看，至年底 HBM 将占先进制程比重 35%，其余则用以生产 LPDDR5 (X) 与 DDR5 产品。

8. 【Canalys：Q1 紫光展锐处理器出货量同比增长 64% 达到 2600 万颗】

《科创板日报》20 日讯，Canalys 最新报告指出，2024 年第一季度，联发科处理器出货量达 1.141 亿颗，同比增长 17%。小米、三星和 OPPO 是前三大贡献者，分别占联发科智能手机处理器出货量的 23%、20%和 17%。高通智能手机处理器出货量增长 11%，达 7500 万颗。46%的出货量分别来自三星和小米。紫光展锐在前五大智能手机处理器厂商中增长最快，同比增长 64%，达到 2600 万颗。得益于其主要合作伙伴传音在亚太、欧洲、中东非以及拉美地区等新兴市场的扩张，使得这些地区智能手机出货量均实现两位数的增长。

9. 【英伟达发布强劲营收预测 凸显人工智能势头持续】

财联社 5 月 23 日电，处于人工智能热潮中心的芯片制造商英伟达再次给出乐观的销售预测，表明人工智能计算方面的支出仍然强劲。该公司周三在声明中表示，预

计第二财季收入约为 280 亿美元。据媒体汇总的数据，分析师平均预计为 268 亿美元。截至 4 月的第一财季业绩也超出预期。乐观的前景巩固了英伟达作为人工智能支出最大受益者的地位。该公司所谓的人工智能加速器——帮助数据中心开发聊天机器人和其他尖端工具的芯片——在过去两年成为热门商品，推动该公司销量飙升。英伟达的市值也飙升至 2.3 万亿美元上方。

10. 【中芯国际首次超越格罗方德和联华电子 跃升全球第三大芯片代工巨头】

财联社 5 月 24 日电，据 Counterpoint Research 的数据显示，按第一季度收入计算，国内晶圆代工厂“一哥”中芯国际首次超越格罗方德和联华电子，跃升全球第三大芯片代工企业。

11. 【Canalys：2024 年 Q1 东南亚智能手机市场增长 12%】

《科创板日报》24 日讯，Canalys 最新报告指出，2024 年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比增长 12%至 2350 万部。这是表明宏观经济已有复苏迹象，但出货量仍远低于 2023 年之前的水平。Canalys 预测，2024 年东南亚的智能手机出货量将增长 4%。多数厂商对于期待自然更新周期带来的外部销售大幅增长持谨慎态度。

12. 【小米集团：第一季度智能手机业务收入为 465 亿元 同比增长 32.9%】

财联社 5 月 23 日电，小米集团财报显示，第一季度，智能手机业务收入为 465 亿元，同比增长 32.9%；小米全球智能手机出货量为 4060 万台，同比增长 33.7%。小米集团表示，2024 年第一季度，在中国大陆地区人民币 5,000 - 6,000 元价位段的智能手机市占率达到 10.1%，同比提升 5.8 个百分点。由于 ASP 较低的境外市场收入占比增加，智能手机的整体 ASP 由 2023 年第一季度的每部 1,151.6 元轻微减少 0.6%至 2024 年第一季度的每部 1,144.7 元。

3. 公司公告与动态

1. 【中微公司尹志尧：未来 5-10 年目标覆盖 50%-60%的集成电路关键设备】

《科创板日报》22 日讯，中微公司董事长、总经理尹志尧今日在业绩会上表示，该公司将继续坚持以高端半导体设备为核心，开发更多有竞争力的设备产品；同时积极考虑通过投资和并购，推动公司更快发展。“未来 5-10 年，中微公司将通过自主研发以及和合作伙伴一起努力，覆盖 50%-60%的集成电路关键设备。”（记者 郭辉）

4. 半导体产业数据更新

4.1 智能手机出货数据

全球智能手机出货数据: 根据 IDC 数据, 2024 年第一季度全球智能手机出货量为 2.89 亿台, 同比增长 7.74%, 环比下降 11.25%; 2023 年全年智能手机出货量为 11.63 亿台, 相比 2022 年下滑 3.29%;

国内智能手机出货数据: 根据工信部数据, 2024 年 3 月国内智能手机出货量为 2,021.8 百万台, 同比下降 6.20%, 环比增长 43.98。2024 年一季度国内智能手机出货量合计为 6,377.3 万台, 同比增长 5.78%。

图 2: 全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/03) 图 3: 国内智能手机月度出货情况 (2022/03-2024/03)



资料来源: IDC, 东莞证券研究所

资料来源: 工信部, 东莞证券研究所

4.2 新能源汽车销售数据

新能源汽车销售数据: 据工信部, 2024 年 4 月, 国内新能源汽车总销量为 85.0 万辆, 同比增长 33.6%, 环比增长 36.03%, 2024 年 4 月国内汽车总销量为 235.9 万台, 其中新能源汽车销量占比为 36.03%。

图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 (2022/01-2024/04) 图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 (2022/01-2024/04)



资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

4.3 全球、国内半导体月度销售数据

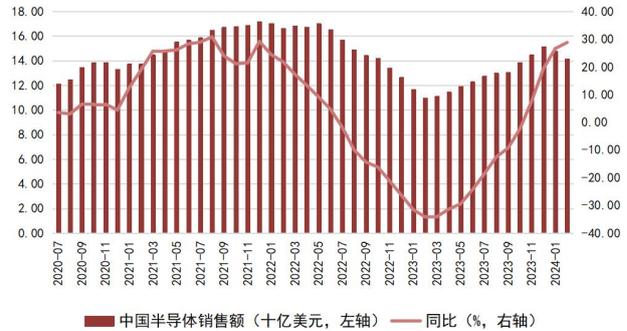
全球、中国半导体销售数据: 根据美国半导体行业协会数据, 2024 年 3 月全球半导体销

销售额为 459.1 亿美元，同比增长 15.20%，环比下降 0.56%；国内半导体 2023 年 3 月销售额为 141.4 亿美元，同比增长 27.40%，环比增长 0.07%。2024 年第一季度全球半导体销售额为 1,397.1 亿美元，同比增长 15.60%，国内半导体销售额为 430.3 亿美元，同比增长 27.57%。

图 6：全球半导体月度销售情况



图 7：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据

全国、中国大陆半导体设备销售额：根据 SEAJ 数据，2023 年第四季度全球半导体设备销售额为 255.9 亿美元，同比增长 0.94%，其中中国大陆半导体设备销售额为 121.3 亿美元，同比增长 90.81%。

图 8：全球半导体设备销售额（季度）



图 9：中国大陆半导体设备销售额（季度）



资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

5. 投资建议

景气上行与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。2023 年下半年以来，在传统消费电子需求回暖（以智能手机、PC 为代表）、AI 驱动行业创新（以 AI 服务器、PCB 等为代表）和国产替代持续推进（以半导体设备、材料为代表）的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于 2024 年一季度正式迈入景气上行周期。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。

建议关注标的:

- **半导体设备与材料:** 北方华创(002371)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666);
- **存储芯片:** 兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、佰维存储(688525);
- **先进封装:** 长电科技(600584)、通富微电(002156);
- **射频&CIS:** 卓胜微(300782)、韦尔股份(603501)、思特威(688213);
- **算力芯片:** 海光信息(688041)

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/5/24)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
002371	北方华创	公司 2023 年实现营收 220.79 亿元, 同比增长 50.32%, 实现归母净利润 38.99 亿元, 同比增长 65.73%; 公司 2024 年一季度实现营收 58.59 亿元, 同比增长 51.36%, 实现归母净利润 1.27 亿元, 同比增长 90.40%。报告期内, 公司持续聚焦主营业务, 不断提升核心竞争力, 应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升; 盈利能力方面, 随着公司营收规模持续扩大, 规模效应开始逐渐显现, 成本费用率稳定下降, 因此报告期内利润增速大于营收增速。
688012	中微公司	公司 2023 年实现营收 62.64 亿元, 同比增长 32.15%, 实现归母净利润 17.86 亿元, 同比增长 52.67%; 公司 2024 年第一季度实现营收 16.05 亿元, 同比增长 31.23%, 实现归母净利润 2.49 亿元, 同比下降 9.53%。2024 年一季度, 公司刻蚀设备持续获得国内外更多客户的认可, 针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升, 其中度刻蚀设备实现收入 13.35 亿元, 较上年同期增长约 64.05%, 刻蚀设备占营业收入的比重由上年同期的 66.55% 提升至本期的 83.20%。费用支出方面, 公司持续加大研发力度, 积极推动多款新品研发, 24Q1 研发投入同比增长约 62.43%, 在业务扩张、人员增长背景下, 公司销售费用和管理费用较上年同期分别增长 0.39 亿元和 0.18 亿元, 拖累公司整体盈利表现。
688120	华海清科	公司 2023 年实现营收 25.08 亿元, 同比增长 52.11%, 实现归母净利润 7.24 亿元, 同比增长 44.29%; 公司 2024 年第一季度实现营收 6.80 亿元, 同比增长 10.40%, 实现归母净利润 2.02 亿元, 同比增长 4.27%。2023 年, 公司持续加大研发投入和生产能力建设, 增强核心竞争力。其中, CMP 产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一, 获得了更多客户的肯定并实现了多次批量销售, 市场占有率不断提高; 公司晶圆再生业务获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货, 同时随着公司 CMP 产品的市场保有量不断扩大, 关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量, 同期营业收入及净利润均实现较大幅度同比增长。
300054	鼎龙股份	公司 2024 年第一季度实现营收 7.08 亿元, 同比增长 29.50%, 实现归母净利润 0.82 亿元, 同比增长 134.86%。公司 2023 年营业收入为 26.67 亿元, 同比下降 2.00%, 实现归母净利润 2.22 亿元, 同比下降 43.08%。分业务来看, 2024 年第一季度, 公司 CMP 抛光垫实现销售收入 1.35 亿元, 同比增长 110.08%, 为全年抛光垫业务逐季度持续放量打下良好基础; 公司 CMP 抛光液、清洗液实现产品销售收入 3,592 万元, 环比增长 24.31%, 同比增长 206.00%, 各型号产品的上量、导入验证稳步推进; 半导体显示材料业务实现产品销售收入 7,021 万元, 环比持平略增, 同比增长 436.49%, 与下游重要面板客户的产品渗透和合作持续加深。
300666	江丰电子	公司 2024 年第一季度实现营收 7.72 亿元, 同比增长 36.65%, 实现归母净利润 0.60 亿元, 同比增长

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/5/24)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		7.16%。公司 2023 年营业收入为 26.02 亿元, 同比增长 11.89%, 实现归母净利润 2.55 亿元, 同比下降 3.35%。报告期内, 受到全球经济环境、半导体行业周期等影响, 公司归母净利润同比下滑, 但公司始终积极扩大全球市场份额, 营收规模实现增长; 同时, 公司持续加大研发投入, 积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目, 强化半导体精密零部件领域的战略布局, 市场认可度不断提高。后续随着外围环境及行业周期好转公司的核心竞争力和盈利能力有望加强。目前, 上述项目的扩产和推进, 导致相应成本费用有所增加, 同时受到产品销售结构变化、精密零部件和第三代半导体材料新品开发试制增加等多种因素影响, 公司 2023 年经营业绩较上年同期有所下降。
603986	兆易创新	公司 2023 年实现营收 57.61 亿元, 同比下降 29.14%, 实现归母净利润 1.61 亿元, 同比下降 92.15%; 公司 2024 年一季度实现营收 16.27 亿元, 同比增长 21.32%, 实现归母净利润 2.05 亿元, 同比增长 36.45%, 一季度归母净利润超过 2023 年总和。公司作为国内利基型存储与 MCU 领先企业, 在 Nor Flash、SLC Nand Flash、DRAM 和 MCU 等产品均有布局。2024 年第一季度, 伴随下游消费需求回暖及产品价格企稳, 叠加通过提升销量扩大市占率, 公司多条产品线如 Nor Flash、DRAM 产品出货量稳步增加, 24Q1 经营业绩实现强势反弹。
688008	澜起科技	公司 2023 年实现营收 22.86 亿元, 同比下降 37.76%, 实现归母净利润 4.51 亿元, 同比下降 65.30%; 公司 2024 年一季度实现营收 7.37 亿元, 同比增长 75.74%, 实现归母净利润 2.23 亿元, 同比增长 1,032.86%。2023 年一季度, 内存接口芯片实现恢复性增长, 公司部分芯片开始规模出货, 推动营收及净利润较上年同期大幅增长; 营收结构方面, 公司 DDR 内存接口芯片、PCIe Retimer 及 MRCD/MDB 芯片等较高毛利率产品收入占比提升, 公司互联类芯片产品线毛利率较上年同期增加 6.98 个百分点, 推动公司整体毛利润较上年同期增长 90.29%。
688525	佰维存储	公司 2023 年实现营收 35.91 亿元, 同比增长 20.27%, 实现归母净利润-6.24 亿元, 同比下降 976.68%; 公司 2024 年一季度实现营收 17.27 亿元, 同比增长 305.80%, 实现归母净利润 1.68 亿元, 同比增长 232.97%。自 2023 年第四季度起, 存储行业展现出复苏迹象, 市场需求逐渐增强。在公司积极响应市场变化, 加强与国内外主要客户的合作, 在市场份额和业务发展上取得了显著进展。随着产品价格持续回升, 公司 24Q1 毛利率实现显著提升, 相比 23Q1 增长 29.22 个百分点。
300782	卓胜微	公司 2023 年实现营收 43.78 亿元, 同比增长 19.05%, 实现归母净利润 11.22 亿元, 同比增长 4.95%; 公司 2024 年一季度实现营收 11.90 亿元, 同比增长 67.16%, 实现归母净利润 1.98 亿元, 同比增长 69.83%。从 23Q3 开始, 消费电子市场需求迎来复苏, 公司受益华为旗舰强势回归, 23Q4、Q4 营收均实现同比增长; 2024 年第一季度, 公司 12 英寸 IPD 平台量产启动。自主 IPD 滤波器的 L-PAMiF 和 LFEM 模组已通过客户验证, 进入量产。同时, 自研 MAX-SAW 的 L-PAMiD 模组取得突破, 进入工程样品阶段。公司将集中资源, 持续优化产品性能与技术, 为未来客户推广奠定基础。
603501	韦尔股份	公司 2023 年实现营收 210.21 亿元, 同比增长 4.69%, 实现归母净利润 5.56 亿元, 同比下降 43.89%; 公司 2024 年一季度实现营收 56.43 亿元, 同比增长 30.18%, 实现归母净利润 5.58 亿元, 同比增长 180.50%, 2024 年一季度归母净利润超过 2023 年总和。随着消费市场进一步回暖, 公司下游客户需求有所增长, 伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透, 公司营业收入实现了明显增长; 同时受到产品结构优化以及成本控制等因素影响, 公司产品毛利率逐步恢复, 2024 年一季度公司综合毛利率为 27.89%, 同比提升 3.17%, 环比提升 4.99%。
688213	思特威	公司 2024 年一季度实现营收 8.37 亿元, 同比增长 84.31%, 实现归母净利润 1402.61 亿元, 同比实现扭亏为盈, 24Q1 研发投入合计为 8983.83 亿元, 占营收比重为 10.73%。报告期内, 在智慧安防领域, 受市场回暖以及公司迭代产品性能和竞争力提升的影响, 产品销量上升, 带来销售收入增加; 在智能手机领域, 公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的 XS 系列高阶 5000 万像素产品出货上升, 受此影响, 公司智能手机领域营收显著增长, 同时与客户合作全面加深, 市场占有率持续提升。在智能手机领域, 公司已成功开辟出第二条增长曲线。盈利能力方面, 受到研发效率提高、成本管理能力的

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/5/24)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		增强、产品成本得到有效控制等多因素的影响，公司毛利率得到提高。
600584	长电科技	公司 2023 年实现营收 296.61 亿元，同比下降 12.15%，实现归母净利润 14.71 亿元，同比下降 54.48%；公司 2024 年一季度实现营收 68.42 亿元，同比增长 16.75%，实现归母净利润 1.35 亿元，同比增长 23.01%。2023 年受到全球经济衰退的影响，全球消费电子市场疲软，全球半导体市场处于行业下行周期，导致公司全年业绩承压，但随着消费市场趋于稳定，存储器市场回暖以及人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，公司 2023 年营收及净利润逐季环比抬升，且 24Q1 实现同比双位数增长，表明下游行业景气度正逐步回升。
002156	通富微电	公司 2023 年实现营收 222.69 亿元，同比增长 3.92%，实现归母净利润 1.69 亿元，同比下降 66.24%；公司 2024 年一季度实现营收 52.82 亿元，同比增长 13.79%，实现归母净利润 0.98 亿元，同比增长 2,064.01%。据 SIA 数据显示，2023 年全球半导体行业销售总额相比 2022 年下降 8.2%，导致公司封测环节业务承压，尤其是传统封测业务遭遇较大挑战。从 2023 年下半年开始，半导体行业景气度逐步回升，且人工智能等技术的应用成为行业增长的关键动能之一，带动公司 24Q1 业绩实现触底回升。
688041	海光信息	公司 2024 年一季度实现营收 15.92 亿元，同比增长 37.09%，实现归母净利润 2.89 亿元，同比增长 20.53%。2024 年一季度，公司整体经营情况持续向好，高端处理器产品的产业生态持续扩展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升，进一步夯实了公司的领先优势和市场竞争能力，实现了业绩的持续增长。

资料来源：iFind，东莞证券研究所

6. 风险提示

(1) 终端需求不及预期：从 24Q1 看，半导体行业已进入上行周期，以智能手机为代表的终端需求回暖对板块业绩构成支撑。若后续下游需求不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

(2) 国产替代不及预期：半导体设备与材料、高端元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

(3) 价格竞争加剧：目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

东莞证券研究报告评级体系:

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内, 股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内, 股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 导致无法给出明确的投资评级; 股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明: 本评级体系的“市场指数”, A股参照标的为沪深 300 指数; 新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告, 市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告, 港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系: “保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报, “谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报, “稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报, “积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报, “激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺:

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点, 不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系, 没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益, 或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明:

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司, 具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下, 本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有, 未经本公司事先书面许可, 任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发, 需注明本报告的机构来源、作者和发布日期, 并提示使用本报告的风险, 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的, 应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码: 523000

电话: (0769) 22115843

网址: www.dgzq.com.cn